

行业月度报告

半导体

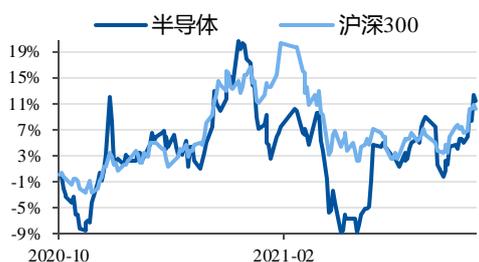
半导体设备出货量终止连续增长，关注四季度景气度变化

2021年10月12日

评级 领先大市

评级变动: 维持

行业涨跌幅比较



%	1M	3M	12M
半导体	-11.22	-15.34	30.84
沪深300	-2.59	-3.66	4.33

何晨

执业证书编号: S0530513080001
hechen@cfzq.com

张看

zhangkan@cfzq.com

分析师

0731-84779574

研究助理

相关报告

- 《半导体：2021年9月半导体行业跟踪：景气度略有分化，扩产打开设备成长空间》
2021-09-16
- 《半导体：2021年8月半导体行业跟踪：中报陆续披露，扩产打开设备成长空间》
2021-08-13
- 《半导体：2021年6月半导体行业跟踪：业绩预告陆续披露，看好半导体国产设备》
2021-07-21

重点股票	2020A		2021E		2022E		评级
	EPS	PE	EPS	PE	EPS	PE	
长电科技	0.73	46.92	1.36	25.18	1.47	23.30	推荐
北方华创	1.08	317.55	1.46	234.9	2.02	169.78	推荐
精测电子	0.99	55.62	1.53	35.99	2.01	27.39	谨慎推荐
中颖电子	0.75	92.67	1.00	69.5	1.35	51.48	谨慎推荐
至纯科技	0.85	56.47	0.95	50.53	1.26	38.1	谨慎推荐
晶晨股份	0.28	396.43	1.46	76.03	2.2	50.45	谨慎推荐
华峰测控	3.26	147.83	4.99	96.58	6.88	70.05	谨慎推荐

资料来源: Wind, 财信证券

投资要点:

- **市场行情回顾:** 2021年9月1日至10月11日，申万半导体指数涨跌幅为-5.95%，表现也大幅弱于各大指数。各细分子板块中半导体材料以区间涨幅为22.04%领涨。从整体估值水平来看，申万半导体板块整体法估值PE为69.93倍，估值处于历史前45.10%分位；中位数法估值PE为73.35倍，估值处于历史前45.10%分位。
- **需求端:** 从IC设计公司月度营收以及第三方数据跟踪来看，三季度包括手机终端和PC（笔电、平板和教育本）在内需求均开始走软。服务器方面，BMC服务商信骅月度营收数据已经连续9个月环比增长，仅在8月份环比小幅下降，同时下游客户将BMC库存从过去的3~4周延伸至7~8周侧面反映云服务商下半年强劲的资本开支扩张。从跟踪的全球主要电子经销商存货数据来看，二季度后库存周转基本恢复至正常水平，而构成主要下游需求的手机、PC和服务器均在四季度处于需求/技术切换的时期，重点关注Q4需求能否延续。
- **供给端:** 晶圆代工端产能维持高水平运转，其中台积电Q2法说会预估自身供应紧缺延续至2022年。以成熟制程为主的联电、力积电和世界先进在8月份创出月度营收新高。跟据台湾经济日报引用，联电预计再次向客户发出晶圆涨价函，该信息是否落地与涨价幅度将成为明年半导体供需平衡时间节点的重要判断依据，也考验IC设计公司三四季度的盈利能力。台股整体封测厂商月度营收呈现逐月爬坡态势，但除龙头日月光以外其余封测厂商月度营收环比持平，考虑到此轮需求失衡的产品以传统封装为主，技术相对成熟，客户的选择性更多；同时封测厂传统封装利润率维持高位，因此受上游晶圆产能约束和自身议价能力影响，封测端价格传导强度与时间弱于晶圆代工。
- **设备端:** 代工厂相继上修资本开支，晶圆代工厂将支出重点开向成熟制程，8寸晶圆扩产又以国内为主。北美半导体设备出货额与日本半

导体设备出货额于7月份延续高增长，但环比增速存在边际放缓。展望未来三年，国内规划的大规模扩产将给国内半导体设备厂商带来机遇，根据测算，在仅考虑本土大陆企业扩产的情况下，国内晶圆厂未来可释放产能为：8寸线产能约27万片，12寸线产能约61.5-62.5万片，其中12寸线中确定为成熟制程的产品约为33.5万片。如考虑安装调试成熟，设备匹配差异不大的8寸线和12寸线上的成熟工艺节点上的扩产，在部分环节取得突破的国内厂商有望充分受益。

- **投资建议：**随着需求与产能错配的现象逐步得到改善，消费电子需求疲软和晶圆代工厂的全面涨价引发对“价增”持续性的担忧；另一方面，从跟踪的主要汽车芯片设计公司以及PC经销商库存水位来看，其库存较正常水平的差距正逐步缩窄，芯片紧缺对下游需求的压制有望进一步改善，后续重点关注“量增”逻辑带来的投资机会。我们维持行业“领先大市”评级，建议优先关注“国产替代”与“资本开支超级周期”叠加下的半导体设备厂商北方华创、至纯科技、精测电子和华峰测控，同时建议关注短期受产能限制，但受益于下游客户对国内芯片产品态度转变，从而有望市占率提升的IC设计公司中颖电子、晶晨股份，封测厂商长电科技。维持行业“领先大市”评级。
- **风险提示：**贸易摩擦加剧，需求不及预期，国产替代放缓。

内容目录

1 投资建议	5
2 市场行情回顾	6
3 行业数据与观点汇总	7
3.1 半导体设备出货量终止连续环比增长，产业景气首现分化.....	7
3.2 台股 IC 设计公司营收增长放缓，Q4 成为供需关系变化观测节点.....	8
4 行业重点新闻	11
4.1 汽车芯片封测厂 Unisem 宣布因疫情关厂一星期.....	11
4.2 工信部和有关部门组建了汽车半导体推广应用工作组，解决当前的供需矛盾突出问题.....	11
4.3 IDC 预计今年半导体将同比增长 17.3%，短缺将在四季度持续缓解.....	11
4.4 TrendForce 调查显示笔电下半年需求放缓，预估 2021 全年笔电出货可达 2.4 亿台.....	12
5 重点公司及新上市公司新闻	12
5.1 拓邦股份 (002139.SZ)：发布 2021 年限制性股权激励预案.....	12
5.2 北方华创 (002371.SZ)：前三季度净利润同比增长 82.3%~117.21%.....	12
5.3 立昂微 (605358.SH)：发布 2021 年前三季度业绩预增公告.....	13
5.4 普冉股份 (688766.SH) 发布 2021 年限制性股票激励计划.....	13
5.5 普冉股份 (688766.SH) 公开发行股票上市.....	13
5.6 宏微科技 (688711.SH) 公开发行股票上市.....	13
6 风险提示	14

图表目录

图 1：2021 年 9 月 1 日至 10 月 11 日申万半导体指数表现.....	6
图 2：2021 年 9 月 1 日至 10 月 11 日申万电子各子板块指数表现.....	6
图 3：截止 2021 年 10 月 11 日申万半导体板块整体法 PE 水平.....	7
图 4：截止 2021 年 10 月 11 日申万半导体板块中值法 PE 水平.....	7
图 5：全球半导体销售额月度数据变化.....	7
图 6：中国半导体销售额月度数据变化.....	7
图 7：全球半导体设备和材料销售额季度数据变化.....	8
图 8：中国大陆半导体设备和材料销售额季度数据变化.....	8
图 9：北美半导体设备制造商月度出货额与同比变动.....	8
图 10：日本半导体设备制造商月度出货额与同比变动.....	8
图 11：联发科月度营收变动与同比增速.....	9
图 12：联咏月度营收变动与同比增速.....	9
图 13：瑞昱月度营收变动与同比增速.....	9
图 14：矽力-KY 月度营收变动与同比增速.....	9
图 15：台积电月度营收变动与环比增速.....	10
图 16：联电月度营收变动与环比增速.....	10
图 17：力积电月度营收变动与环比增速.....	10
图 18：世界先进月度营收变动与环比增速.....	10
图 19：日月光投控月度营收变动与同比增速.....	10
图 20：力成月度营收变动与同比增速.....	10

表 1：2021 年 9 月 1 日-10 月 11 日申万半导体行业涨跌幅前五名..... 6

1 投资建议

【需求端】消费类需求疲软，服务器需求延续景气。从IC设计公司月度营收以及第三方数据跟踪来看，三季度包括手机终端和PC（笔电、平板和教育本）在内需求均开始走软。服务器方面，BMC服务商信骅月度营收数据已经连续9个月环比增长，仅在8月份环比小幅下降，同时下游客户将BMC库存从过去的3~4周延伸至7~8周侧面反映云服务商下半年强劲的资本开支扩张。从跟踪的全球主要电子经销商存货数据来看，二季度后库存周转基本恢复至正常水平，而构成主要下游需求的手机、PC和服务器均在四季度处于需求/技术切换的时期，重点关注Q4需求能否延续。

【供给端】产能利用率维持高水位，Q4涨价是否延续与幅度或称明年供需判断重要依据。晶圆代工端产能维持高水平运转，主要代工厂产能利用率接近或超过100%，并相继取消折扣并提高晶圆报价，其中台积电Q2法说会预估自身供应紧缺延续至2022年。以成熟制程为主的联电、力积电和世界先进在经历6月份的短暂调整后，Q3涨价在7月份得到直观体现，并在8月份创出月度营收新高。跟据台湾经济日报引用，联电预计再次向客户发出晶圆涨价函，该信息是否落地与涨价幅度将成为明年半导体供需平衡时间节点的重要判断依据，也考验IC设计公司三四季度的盈利能力。台股整体封测厂商月度营收呈现逐月爬坡态势，但除龙头日月光以外其余封测厂商月度营收环比持平，考虑到此轮需求失衡的产品以传统封装为主，技术相对成熟，客户的选择性更多；同时封测厂传统封装利润率维持高位，因此受上游晶圆产能约束和自身议价能力影响，封测端价格传导强度与时间弱于晶圆代工。

【设备端】半导体设备企业将持续受益于资本开支的超级周期。以台积电为代表，代工厂相继上修资本开支，在资本开支与设备供应约束下，先进制程处于寡头垄断的态势，其余晶圆代工厂将支出重点开向成熟制程，8寸晶圆扩产又以国内为主，北美半导体设备出货额与日本半导体设备出货额于7月份延续高增长，但环比增速存在边际放缓。展望未来三年，国内规划的大规模扩产将给国内半导体设备厂商带来机遇，根据测算，在仅考虑本土大陆企业扩产的情况下，国内晶圆厂未来可释放产能为：8寸线产能约27万片，12寸线产能约61.5-62.5万片，其中12寸线中确定为成熟制程的产品约为33.5万片。如考虑安装调试成熟，设备匹配差异不大的8寸线和12寸线上的成熟工艺节点上的扩产，在部分环节取得突破的国内厂商有望充分受益。

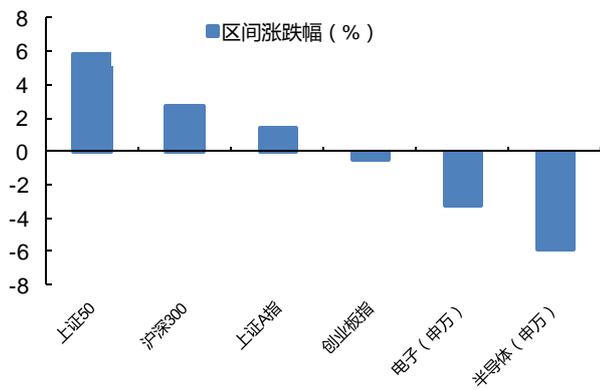
【投资建议】需求与产能的错配现象逐步得到改善，后续重点关注量增逻辑带来的投资机会。随着需求与产能错配的现象逐步得到改善，消费电子需求疲软和晶圆代工厂的全面涨价引发对“价增”持续性的担忧；另一方面，从跟踪的主要汽车芯片设计公司以及PC经销商库存水位来看，其库存较正常水平的差距正逐步缩窄，芯片紧缺对下游需求的压制有望进一步改善，后续重点关注“量增”逻辑带来的投资机会。我们维持行业“领先大市”评级，建议优先关注“国产替代”与“资本开支超级周期”叠加下的半导体设备厂商，同时建议关注短期受产能限制，但受益于下游客户对国内IC产品态度转变，从而有望市占率提升的IC设计公司。

2 市场行情回顾

2021年9月1日至10月11日，申万半导体指数涨跌幅为-5.95%，同期上证A指、沪深300指数、上证50指数和创业板指数涨跌幅分别为1.35%、2.72%、5.79%和-0.56%，半导体板块涨幅弱于电子板块，表现也大幅弱于各大指数。

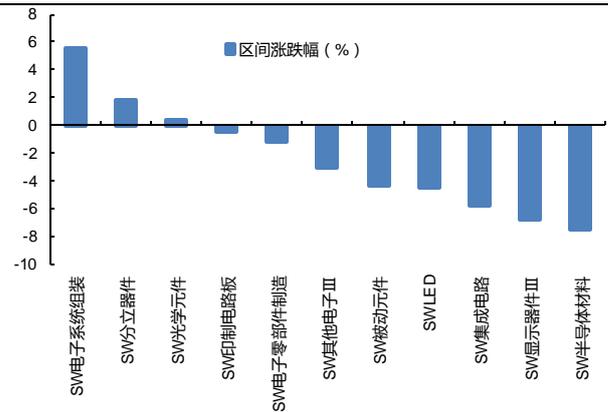
各细分子板块方面，申万电子系统组装、分立器件、光学元件涨幅靠前且涨幅为正，半导体各个子板块跌幅较大，其中半导体材料以-7.48%领跌各板块。

图1：2021年9月1日至10月11日申万半导体指数表现



资料来源：Wind，财信证券

图2：2021年9月1日至10月11日申万电子各子板块指数表现



资料来源：Wind，财信证券

从个股情况来看，2021年9月-10月11日申万半导体行业上涨家数8家，下跌家数38家，涨跌幅中位数为-8.17%，剔除上市不足一年的新股后申万半导体行业涨幅排名前五的股票为斯达半导(+16.03%)、晓程科技(+15.67%)、汇顶科技(+6.46%)、捷捷微电(+6.31%)和扬杰科技(+4.58%)。帝科股份(-36.00%)、赛微电子(-21.71%)和博通集成(-21.03%)涨幅靠后。

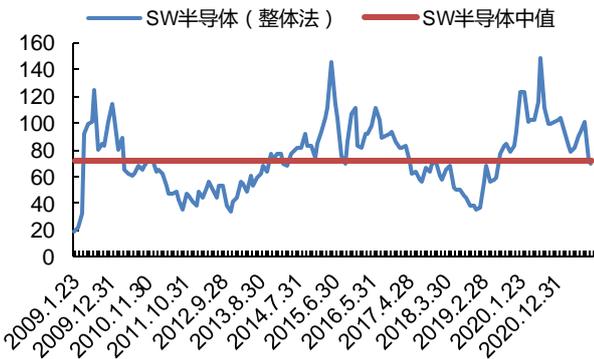
表1：2021年9月1日-10月11日申万半导体行业涨跌幅前五名

行业涨幅前五名			行业跌幅前五名		
代码	名称	涨幅	代码	名称	涨幅
603290.SH	斯达半导	16.03%	300842.SZ	帝科股份	-36.00%
300139.SZ	晓程科技	15.67%	300456.SZ	赛微电子	-21.71%
603160.SH	汇顶科技	6.46%	603068.SH	博通集成	-21.03%
300623.SZ	捷捷微电	6.31%	300613.SZ	富瀚微	-18.72%
300373.SZ	扬杰科技	4.58%	300706.SZ	阿石创	-17.04%

资料来源：wind，财信证券

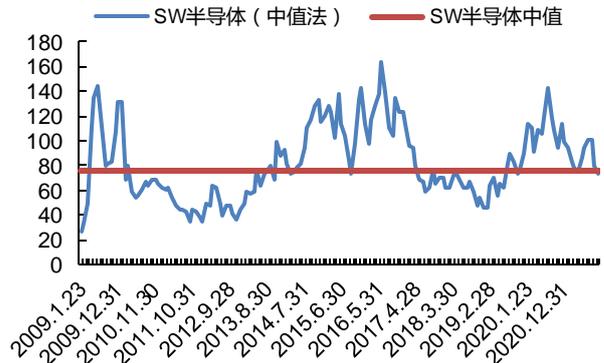
从整体估值水平来看，申万半导体板块整体法估值PE(TTM，剔除负值)为69.93倍，估值处于历史前45.10%分位，自2009年起整体法的估值中位数为71.97倍；申万半导体中值法估值PE(TTM，剔除负值)为73.35倍，估值处于历史前45.10%分位，自2009年起中值法的估值中位数为76.14倍。

图 3: 截止 2021 年 10 月 11 日申万半导体板块整体法 PE 水平



资料来源: Wind, 财信证券

图 4: 截止 2021 年 10 月 11 日申万半导体板块中值法 PE 水平



资料来源: Wind, 财信证券

3 行业数据与观点汇总

3.1 半导体设备出货量终止连续环比增长, 产业景气首现分化

根据 SIA 数据, 2021 年 8 月全球半导体销售额接近 472 亿美元, 同比增长 29.70%, 环比增长 3.30%, 同期中国半导体销售额达到 164.60 亿美元, 同比增长 30.80%, 在需求与涨价的双重推动下, 半导体月度销售规模双双创下历史新高, 进入下半年海外需求与产能逐步恢复, 海内外需求两旺。

设备端则在三季度出现分化, 尽管 2021 年二季度全球半导体设备销售额达到创纪录的 276.8 亿美元, 但从月度数据上, 北美半导体设备出货额于 8 月份为 36.50 亿美元, 同比增长 37.56%, 环比下降 5.38%, 同时也终止了出货额连续 8 个月的环比增长, 后续四季度的拉货情况成为供给端的重要观测指标。日本半导体设备出货额为 245.72 亿日元 (21.81 亿美元), 同比增长 30.42%, 环比增长 2.07%。

图 5: 全球半导体销售额月度数据变化



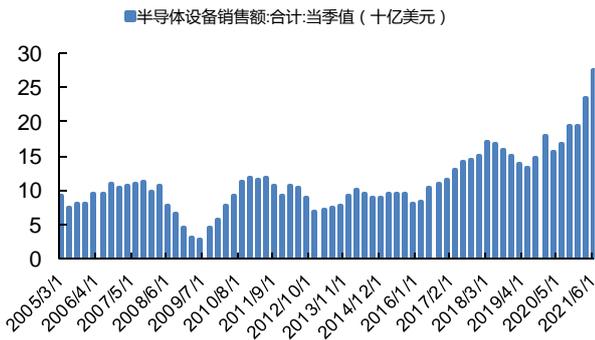
资料来源: SIA, Wind, 财信证券

图 6: 中国半导体销售额月度数据变化



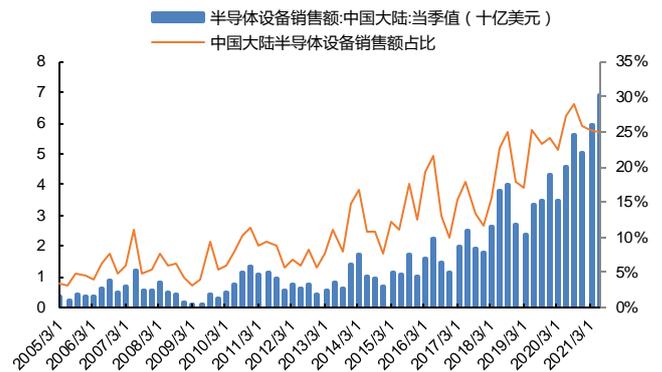
资料来源: SIA, Wind, 财信证券

图 7：全球半导体设备和材料销售额季度数据变化



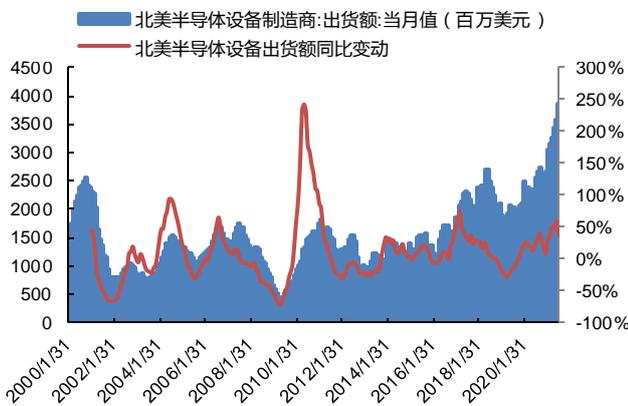
资料来源：Wind，财信证券

图 8：中国大陆半导体设备和材料销售额季度数据变化



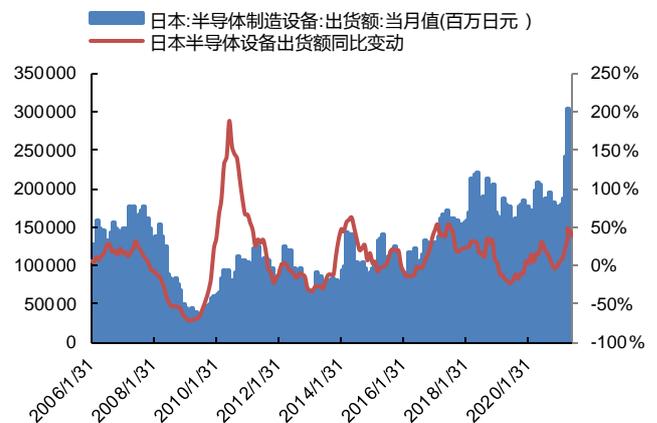
资料来源：Wind，财信证券

图 9：北美半导体设备制造商月度出货额与同比变动



资料来源：Wind，财信证券

图 10：日本半导体设备制造商月度出货额与同比变动



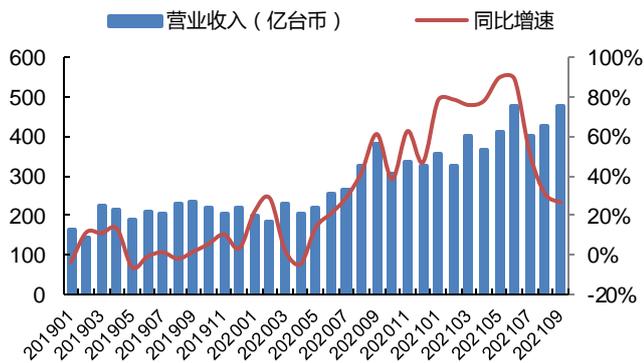
资料来源：Wind，财信证券

3.2 台股 IC 设计公司营收增长放缓，Q4 成为供需关系变化观测节点

台股 IC 设计类公司从 2020 年下半年开始进入景气区间，月度合计营收由 500-600 亿区间快速上扬，2021 年 6 月台股 IC 设计公司合计营收跨过 1000 亿台阶，但在 7 月份再度下跌至 961.10 亿元。

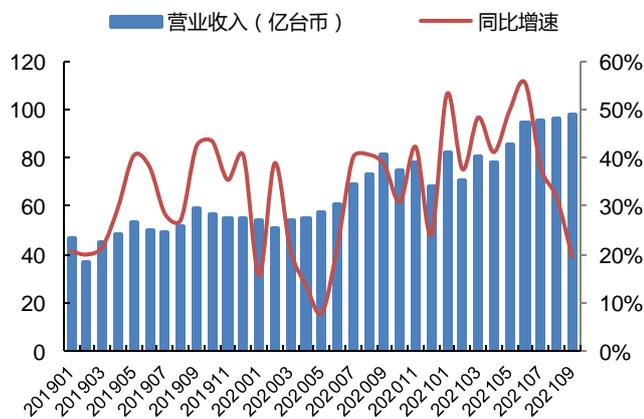
从月度营收变化来看，各代表性台股 IC 设计类公司同比增速均出现大幅下滑，近三月月度营收环比变化基本持平甚至有所下降。随着包括消费电子/笔电需求在三季度进一步放缓，中间环节的经销商库存已开始回归正常水位，同环比的变化也反映当前时点与 2020 年的行业景气变化，由 PC（笔电、教育本和平板）、手机和服务器等带来共振式需求将在四季度进一步分化。

图 11: 联发科月度营收变动与同比增速



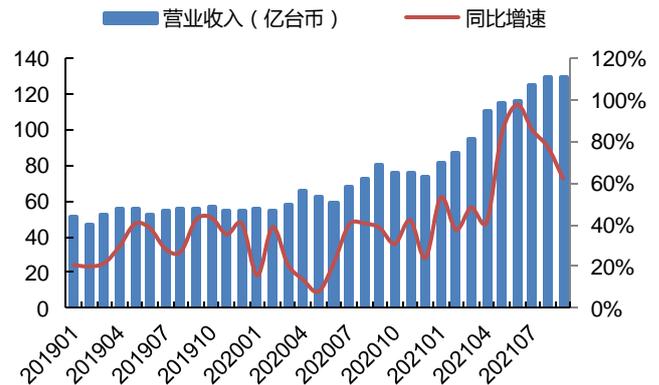
资料来源: Wind, 财信证券

图 13: 瑞昱月度营收变动与同比增速



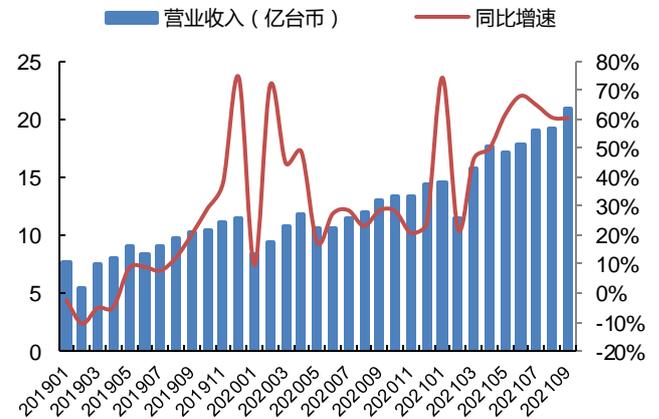
资料来源: Wind, 财信证券

图 12: 联咏月度营收变动与同比增速



资料来源: Wind, 财信证券

图 14: 矽力-KY 月度营收变动与同比增速

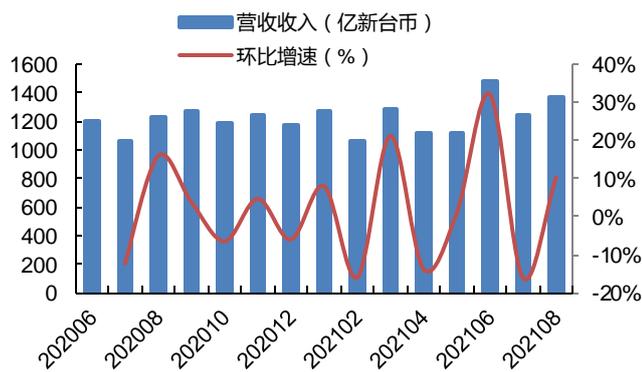


资料来源: Wind, 财信证券

台积电涨价效应立竿见影，其余厂商环比增速放缓。台积电 2021 年 9 月份录得营收 1526.85 亿新台币，环比增长 11.13%，超过 6 月份月度营收高点。为维持法说会预计的营收指引 146-149 亿美元，台积电于 8 月 25 日通知客户，16/12nm 以下（含 12nm）的先进制程报价调涨 10%，12nm 以上的成熟制程上调 20% 左右，则 9 月月度营收变动主要来自于涨价。产能方面，当前主要的新增产能来自于 N5/N3 扩产，美国亚利桑那 12 寸厂计划 2022H2 进行设备入厂，而南京厂的扩产则要到 2022H2，同时台积电董事会批准了 175.72 亿美元的资本开支，用途包括安装先进技术能力、工厂建设、第四季度研发资本投资和持续的资本支出。

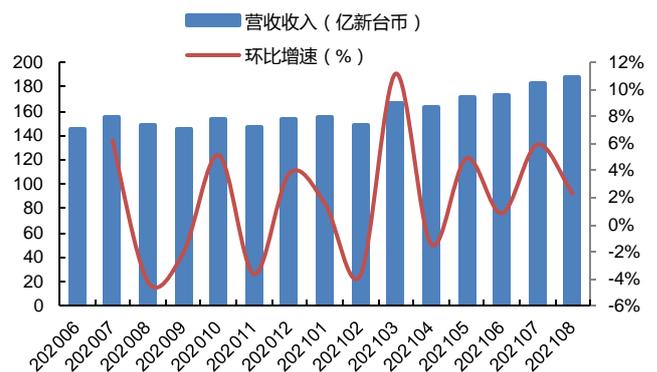
以成熟制程为主的联电、力积电和世界先进在经历 6 月份的短暂调整后，Q3 涨价在 7 月份得到直观体现，并在 8 月份创出月度营收新高。跟据台湾经济日报引用，联电预计再次向客户发出晶圆涨价函，该信息是否落地与涨价幅度将成为明年半导体供需平衡时间节点的重要判断依据，也考验 IC 设计公司四季度的盈利能力。

图 15: 台积电月度营收变动与环比增速



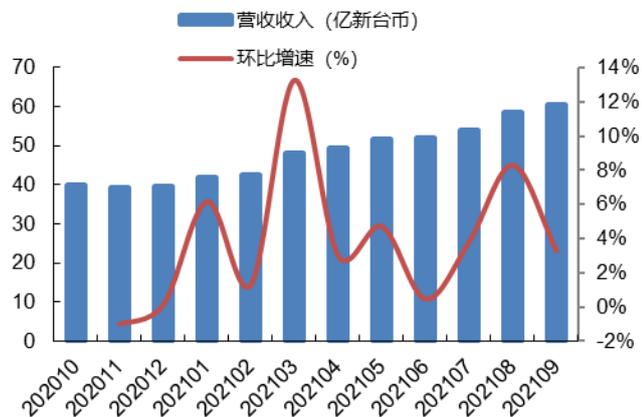
资料来源: Wind, 财信证券

图 16: 联电月度营收变动与环比增速



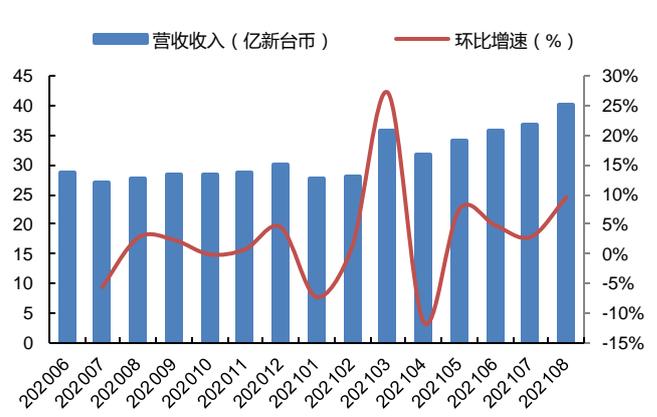
资料来源: Wind, 财信证券

图 17: 力积电月度营收变动与环比增速



资料来源: Wind, 财信证券

图 18: 世界先进月度营收变动与环比增速



资料来源: Wind, 财信证券

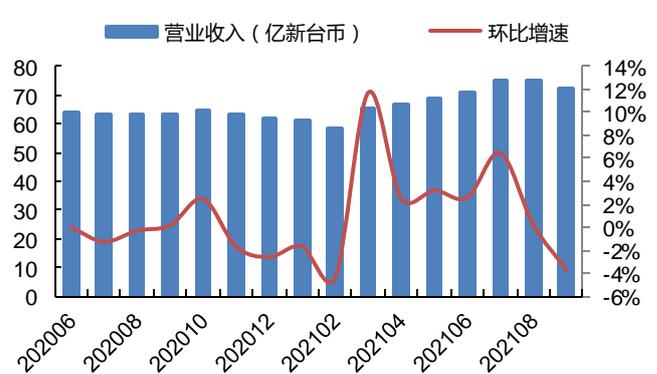
封测企业产能受地域疫情影响较大。2021年9月日月光投资实现营收537.35亿新台币，同比增长22.33%，环比增长6.51%。2021年整体封测厂商月度营收呈现逐月爬坡态势，目前日月光在2021年Q2法说会指出ATM(封装与测试)需求比之前预计更加强健，设备吃紧状况延续到2022年，而主要IDM厂商封测产能集中地马来西亚和菲律宾等地区受疫情影响严重，被迫向第三方OSAT厂转移，从而带动营收增长。

图 19: 日月光投控月度营收变动与同比增速



资料来源: Wind, 财信证券

图 20: 力成月度营收变动与同比增速



资料来源: Wind, 财信证券

4 行业重点新闻

4.1 汽车芯片封测厂 Unisem 宣布因疫情关厂一星期

马来西亚封测大厂 Unisem 当地时间周三（8日）宣布，其怡保工厂从9月8日到15日将关闭7天，主要为多名员工感染新冠病毒，已造成三人死亡，此次关停造成的产量损失约占公司全年总产量的2%，Unisem 是马来西亚当地大型芯片封测厂之一，为英飞凌、意法半导体在内的主要客户提供汽车芯片封测服务，2019年初华天科技收购 Unisem 58.94%的股份，支付对价约为23.48亿人民币，当前 Unisem 占华天科技营业收入的比重约在四分之一左右，如禁令进一步延续将对华天三季度营收带来小幅负面影响。

信息来源：WSTS

4.2 工信部和有关部门组建了汽车半导体推广应用工作组，解决当前的供需矛盾突出问题

针对目前供需矛盾紧张的突出问题，工信部和有关部门组建了汽车半导体推广应用工作组，以专门协调机制来解决当前的供需矛盾突出问题。加强地方政府、汽车整车企业和芯片制造企业对接，进一步推进供需精准化，来缓解或者尽可能减少对汽车业发展的影响，提高自身的供给能力。特别是针对当前一些特定的芯片生产供应极度短缺问题，组织行业协会和企业加强联系，推动一些国内特别是国外的企业复工复产，尽可能地保障一些特定芯片的供应。同时，采取一些措施加快推动替代方案，通过简化审批程序、简化流程加快审批，使替代芯片尽快地推广应用。

信息来源：工信部

4.3 IDC 预计今年半导体将同比增长 17.3%，短缺将在四季度持续缓解

据研究机构 IDC 称，预计 2021 年半导体市场将增长 17.3%，而 2020 年为 10.8%。其中手机、笔记本电脑、服务器、汽车、智能家居、游戏、可穿戴设备以及 Wi-Fi 接入点等引领了内存价格上涨。但值得注意的是，随着产能加速扩张，IC 短缺将在 2021 年第四季度持续缓解，目前在三季度，晶圆制造产能基本上满足需求，但更大的问题是封装和材料短缺。按照主要晶圆厂资本开支与投产时间推算，行业将在 2022 年年中达到平衡，随着 2022 年底和 2023 年开始大规模产能扩张，2023 年或将出现产能过剩。

信息来源：IDC

4.4 TrendForce 调查显示笔电下半年需求放缓，预估 2021 全年笔电出货可达

2.4 亿台

根据 TrendForce 调查显示，自今年下半年七月起，随着各国疫情趋缓，进而使整体笔电需求放缓，其中 Chromebook 衰退约五成。然欧美等消费大国逐渐返回办公室带动一波商用换机潮，加上品牌因应塞港问题而提前冲刺第四季出货，反成为第三季笔电需求的支撑力道，预估 2021 年整体笔电出货量将达 2.4 亿台，年增 16.4%。

从跟踪的全球主要电子经销商存货数据来看，二季度后库存周转基本恢复至正常水平，而构成主要下游需求的手机、PC 和服务器均在四季度处于需求/技术切换的时期，重点关注 Q4 需求能否延续。

信息来源：TrendForce

5 重点公司及新上市公司新闻

5.1 拓邦股份 (002139.SZ)：发布 2021 年限制性股权激励预案

公司发布 2021 年限制性股票激励计划（预案），激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总数不超过 3400 万股，限制性股票授予价格为每股 7.23 元。公司本次激励计划的考核年度为 2022-2024 年，年度公司业绩考核目标为 2022/2023/2024 营收较 2020 年基数增长率分别不低于 70%/120%/180%，或扣非净利润较 2020 年基数增长率分别不低于 100%/150%/220%。此次股权激励是过去的激励计划的延续，稳定核心员工与公司的利益关系，同时较高的股权激励考核目标也表明行业的长期的成长性。

信息来源：公司公告

5.2 北方华创 (002371.SZ)：前三季度净利润同比增长 82.3%~117.21%

北方华创 (002371.SZ) 发布业绩预告，预计 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润约 5.95 亿元~7.09 亿元，同比增长 82.3%~117.21%，2021 年前三季度，受益于下游市场需求拉动，半导体装备及电子元器件业务实现持续增长，使得公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润均实现同比增长。随着国产替代的推进，预计仅由我国大陆地区主导的大型集成电路项目投资规模超过 2000 亿元，将在未来 1-2 年陆续落地，最近的中芯国际和上海自贸区成立合资公司，建设产能为 10 万片/月的 12 寸线，聚焦于 28 纳米及以上技术节点，投资约 88.7 亿美元，北方华创作为产品线较为齐全的国内半导体设备提供商将在后续受益。

信息来源：公司公告

5.3 立昂微 (605358.SH): 发布 2021 年前三季度业绩预增公告

立昂微 (605358.SH) 发布 2021 年前三季度业绩预增公告, 预计 2021 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 37,226.75 万元至 41,145.36 万元, 与上年同期相比, 将增加 24,140.82 万元至 28,059.43 万元, 同比增长 184.48 至 214.42%。报告期内, 公司受益于半导体行业供需失衡带来的机遇, 市场需求旺盛, 公司销售订单饱满, 主要产品产销量大幅提升, 叠加产品涨价等因素影响, 公司营收同比大幅增长, 盈利能力显著提升。报告期内, 公司持续加大新产品新技术的开发力度, 持续推进优质客户开拓, 并加大与战略级客户的合作力度, 进一步优化了产品结构。12 英寸硅片方面, 经过前期的客户拓展和产品验证, 技术能力已覆盖 14nm 以上技术节点逻辑电路, 功率器件及图像传感器件覆盖客户所需技术节点且已大规模出货; 8 英寸硅片产销量进一步放大, 市场占有率进一步提升; 半导体功率器件芯片方面, 车规级功率器件芯片、光伏用旁路二极管控制芯片产销量大幅提升; 化合物半导体射频芯片产销量也稳步提升。

信息来源: 公司公告

5.4 普冉股份 (688766.SH) 发布 2021 年限制性股票激励计划

普冉股份 (688766.SH) 发布 2021 年限制性股票激励计划, 本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 35 万股, 约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.97%。该激励计划首次授予的激励对象共计 112 人, 包括公司公告该激励计划时在公司任职的董事会认为需要激励的人员。

信息来源: 公司公告

5.5 普冉股份 (688766.SH) 公开发行股票上市

公司的主营业务是非易失性存储器芯片的设计与销售, 目前主要产品包括 NOR Flash 和 EEPROM 两大类非易失性存储器芯片, 属于通用型芯片, 可广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。例如, 根据存储需求的不同, 公司的 NOR Flash 产品应用于低功耗蓝牙模块、TWS 耳机、手机触控和指纹、TDDI (触屏)、AMOLED (有源矩阵有机发光二极管面板)、可穿戴设备、车载导航和安全芯片等领域, 公司的 EEPROM 产品应用于手机摄像头模组 (含 3-D)、智能仪表、网络通信、家电等领域。

信息来源: 公司招股说明书

5.6 宏微科技 (688711.SH) 公开发行股票上市

公司自设立以来一直从事 IGBT、FRED 为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的设计、研发、生产和销售, 并为客户提供功率半导体器件的解决方案, IGBT、FRED

单管和模块的核心是 IGBT 芯片和 FRED 芯片，公司拥有自主研发设计市场主流 IGBT 和 FRED 芯片的能力。目前，公司产品已涵盖 IGBT、FRED、MOSFET 芯片及单管产品 100 余种，IGBT、FRED、MOSFET、整流二极管及晶闸管等模块产品 400 余种，公司产品性能与工艺技术水平处于行业先进水平。经过多年的积累，公司已拥有较为丰富的优质客户资源，与台达集团、汇川技术、佳士科技、奥太集团、苏州固得、盛弘股份、英可瑞、科士达等行业龙头或知名企业客户建立了较为稳定的配套合作关系。

信息来源：公司招股说明书

6 风险提示

贸易摩擦加剧，需求不及预期，国产替代放缓。

投资评级系统说明

以报告发布日后的 6—12 个月内，所评股票/行业涨跌幅相对于同期市场指数的涨跌幅度为基准。

类别	投资评级	评级说明
股票投资评级	推荐	投资收益率超越沪深 300 指数 15% 以上
	谨慎推荐	投资收益率相对沪深 300 指数变动幅度为 5%—15%
	中性	投资收益率相对沪深 300 指数变动幅度为-10%—5%
	回避	投资收益率落后沪深 300 指数 10% 以上
行业投资评级	领先大市	行业指数涨跌幅超越沪深 300 指数 5% 以上
	同步大市	行业指数涨跌幅相对沪深 300 指数变动幅度为-5%—5%
	落后大市	行业指数涨跌幅落后沪深 300 指数 5% 以上

免责声明

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，作者具有中国证券业协会注册分析师执业资格或相当的专业胜任能力。

本报告仅供财信证券有限责任公司客户及员工使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发送，概不构成任何广告。

本报告信息来源于公开资料，本公司对该信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本公司对已发报告无更新义务，若报告中所含信息发生变化，本公司可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司及本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此作出的任何投资决策与本公司及本公司员工或者关联机构无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人（包括本公司客户及员工）不得以任何形式复制、发表、引用或传播。

本报告由财信证券研究发展中心对许可范围内人员统一发送，任何人不得在公众媒体或其它渠道对外公开发布。任何机构和个人（包括本公司内部客户及员工）对外散发本报告的，则该机构和个人独自为此发送行为负责，本公司保留对该机构和个人追究相应法律责任的权利。

财信证券研究发展中心

网址：www.cfzq.com

地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 层

邮编：410005

电话：0731-84403360

传真：0731-84403438